

Shenzhen Deping Electronics co.,ltd

深圳德平电子有限公司

产品编号: RG0402A500J1

特点

产品主要运用于微波集成电路模块，如放大，耦合、衰减、滤波等模块电路。
降低信号电平、用于负载之间的匹配。低寄生参数、使用频率高。
可焊性与键合性良好。

特性参数

外观：金属表面光洁，无外来杂质污染，瓷体表面无裂痕。金属毛刺小于 20um。
键合性能：至少承受 6gf 拉力（25um 直径金丝）。
膜层可焊性：支持金锡焊接，5 秒浸润。
膜层耐高温：400℃5 分钟、180℃2 小时不变色，不气泡。
额定功率：1W

电阻值	频率（GHz）	阻值精度	回损最小值
50 Ω	DC-26GHz	$\pm 5\%$	20dB

仅正面金属化

基板材料：99.6%氧化铝基板，厚度 0.254mm

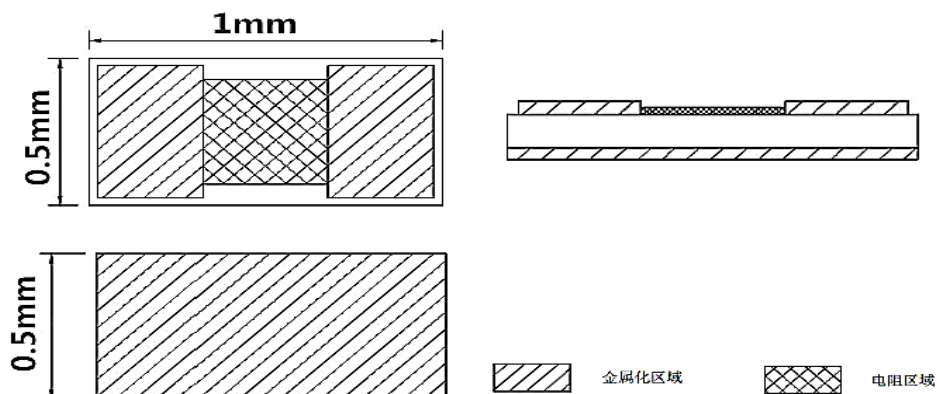
金属化结构：TaN/TiW/Au

TaN：符合方阻要求

TiW：300 - 500A

Au：2.5uM min

尺寸规格



电话:0755-23023733

邮件: Xufei66@dephk.com

传真: 0755-85287900

地址: 深圳市宝安区西乡街道三围航空路 30 号